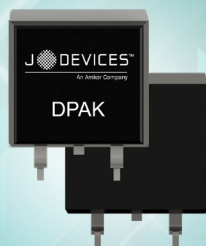


# DPAK (TO-252)

DPAKはJEDEC規格に準拠したミディアムパワーディスクリートです。



## Features

- ▶ Alワイヤボンディングによる低オン抵抗および高電流密度
- ▶ プローブテストからファイナルテスト/パッキングまでのフルターンキーソリューション
- ▶ Pbフリーめっき

## Under Development

- ▶ 環境に配慮したダイアタッチ Pbフリーはんだ
- ▶ ハロゲンフリーモールド樹脂

## Process Highlights

- ▶ インターコネクト：Alワイヤボンディング
- ▶ めっき：100%無光沢Sn
- ▶ マーキング：レーザーマーク

## Applications

DPAKは低オン抵抗と高速スイッチングMOSFET向けに設計されたミディアムパワーアプリケーションに最適なパッケージです（基準値80W\*/60A）。  
最適な用途：

- ▶ モータードライバ
- ▶ 電源回路
- ▶ DC/DCコンバータ
- ▶ 民生品
- ▶ 自動車向け製品

\*Tc = 25°C, Tj = Max150°C

## Reliability Qualification

J-Devicesのパッケージは実績のある信頼性の高い部材で製造されています。

- ▶ 前処理条件：JEDEC標準（HTSを除く）
- ▶ 85°C/85% RH, 168 hours, IR reflow 260°C 3X
- ▶ PCT：121°C/100% RH/2 atm, 96 hours
- ▶ 温度サイクル：-65°C/+150°C, 300 cycles
- ▶ 高温保管（HTS）：150°C, 1000 hours

## Test Service

J-DevicesはMOSFET、インテリジェントパワーデバイスなどの様々なパワーディスクリートのテストを含むフルターンキーソリューションを提供いたします。

- ▶ パワーディスクリートテスト：
  - ▷ DC
  - ▷ キャパシタンス \*1
  - ▷ Rg \*1
  - ▷ アバランシェ試験
  - ▷ 熱抵抗
- ▶ プログラムコンバージョン
- ▶ 電氣的不良解析
- ▶ マーキング、外観検査、テープ&リール 一体機

\*1 サンプリングテストのみ

# DPAK (TO-252)

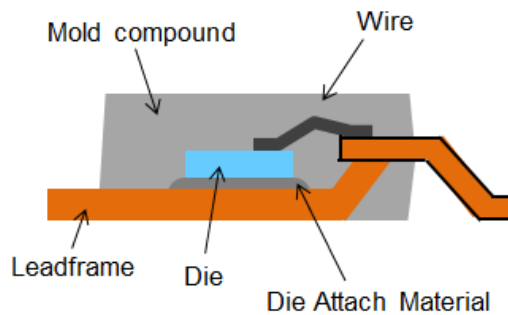
## Standard Materials

- ▶ リードフレーム：Cu（ワイヤボンディング領域にNiめっき）
- ▶ ダイアタッチ：Pbはんだ
- ▶ インターコネクト：Alワイヤ 11.8 mil MAX
- ▶ モールド樹脂：ハロゲン

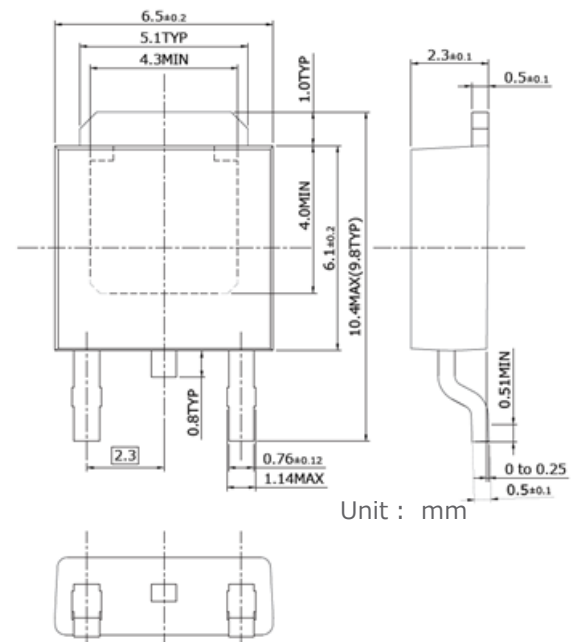
## Shipping

- ▶ テープ&リール
  - ▷ 2000 pcs/リール
  - ▷ テープ幅 10.7 mm
  - ▷ リール Φ = 330 mm
- ▶ バーコードラベル

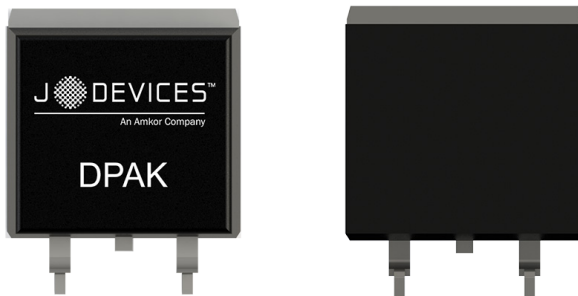
## Cross-section



## Package Outline Drawing



## Top & Bottom View



詳細については[amkor.com](http://amkor.com)にアクセス、または[sales@amkor.com](mailto:sales@amkor.com) までメールをお送りください。

本文中の情報に関して、Amkorは、それが正確であることまたはかかる情報の利用が第三者の知的権利を侵害しないことについて、いかなる保証もいたしません。Amkorは同情報の利用もしくはそれに対する信頼から生じたいかなる性質の損失または損害についても責任を負わないものとし、また本文書によっていかなる特許またはその他のライセンスも許諾しません。本文書は、いかなる形でも販売の標準契約条件の規定を超え、いかなる製品に対しても、Amkorの保証を拡張させ、または変更することはありません。Amkorは通知することなくいつでもその製品および仕様に変更を行う権利を留保します。Amkorの名前とロゴはAmkor Technology, Inc.の登録商標です。記載されている他の全ての商標は、それぞれの会社の財産です。

© 2018, Amkor Technology Incorporated. All Rights Reserved.DSJD414B Rev Date: 10/18